

3EC-M3-VLP

- ・ 極低粗糙度銅箔，適用於細線路蝕刻之減成法製程。
Low profile copper foil, suitable for fine etching in the subtractive process.
- ・ 高抗張力，於薄銅箔易於操作。
High tensile strength, easy to handle thin foil.
- ・ 最薄之7 μ m銅箔具量產能力。
From 7 μ m, we line up.

用途/Application

- ・ IC封裝載板
/Semiconductor Package
- ・ 高密度互連技術板
/High Density Interconnect
- ・ 軟性電路板
/Flexible Print Board

構成/Composition



生產地點/Production Site

- ・ 日本 / Japan

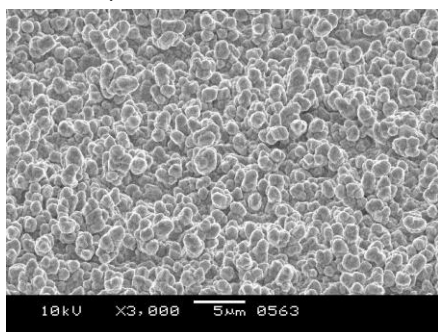
代表性特性數據/Representative

	μ m	Laminate side Rz(μ m)	Tensile Strength (N/mm ²)	Elongation (%)	Peel Strength (kg/cm) ^{@FR-4}
3EC-M3-VLP	9	3.8	500	4	0.9
	12	4.2	500	5	1.2
	18	4.5	500	8	1.4

※上述表列為代表性數據非保證值。

This is representative data, not guarantee.

處理面/Laminate side



阻劑面/ resist side

